

# 世界最小 クラス

Mサイズ クリームはんだ印刷機

## TSP-770



### 特徴 1

## 超コンパクトサイズ

国内他社装置比 (設置占有面積比) **52%**

※当社調べによる、他社様製機種カタログスペック 幅 (W) × 奥行 (D) の平均値との比較  
対応基板サイズは異なります



### 特徴 2

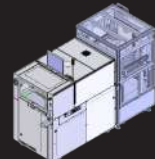
## 優れたカスタマイズ性

業界の“カスタマイズ相談ホットライン”を自負する天電精機が柔軟性のある TSP-770 本体構造と、これまでの要素技術を組み合わせ、ユーザー様のご要望にお応えいたします

特注仕様イメージ図



特殊供給機構



自動化 (マスクチェンジャー)

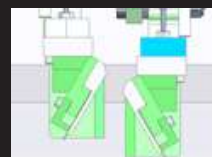
### 特徴 3

## 微細印刷のポテンシャル

充填量確保の難しい狭開口・高アスペクト比の微細印刷に対し天電精機独自の“TH スキージ”との組み合わせにより十分な量のハンダが充填可能です

※印刷部材 (メタルマスク・クリームはんだ) も充填達成の条件となります

TH スキージ



※Mini-LED サイズ  
想定テストサンプル



# 仕様概略

マシンサイズ	W : 893 mm D : 1,417 mm H : 1,405mm ※approx / シグナルタワー・モニター・ネジ等突起物除く
基板サイズ	最小 X : 50mm / Y : 50mm 最大 X : 330mm / Y : 250mm ※最大最小ともに外形寸法公差 JIS C 5013-1996 クラスIIに準拠
適用メタルマスクサイズ	X (W) : 550mm / Y (L) : 650mm 外形公差±2mm X (W) : 650mm / Y (L) : 550mm 外形公差±2mm ※マスクアタッチメント(オプション)使用の場合
製版基準	X-Yセンター基準もしくは、外枠縁手前基準
操作系	OS : Windows10 IoT Edition
搬送方向	右 → 左 ・ 左 → 右 ※ご注文時選択式
搬送基準	手前
タクト	約12秒 ※弊社基準基板にて / 印刷時間、クリーニング時間を除く
スキージ速度	1~200 mm/s ※設定は数値入力 (1mm/s 単位)
機械繰り返し精度	±0.010mm
電源	AC200V 単相 / 5.2 KVA ※max値
重量	1,000kg ※approx

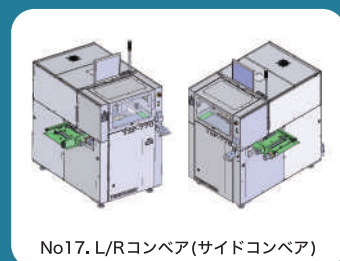
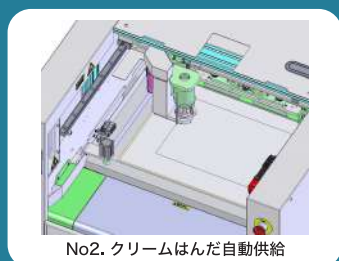
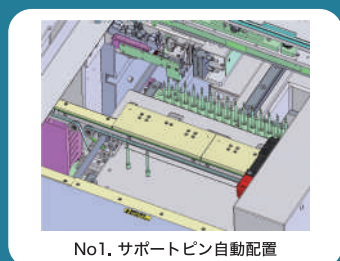
※仕様は予告なく変更する場合がございます

# オプション

No	オプション名	No	オプション名	No	オプション名
1	サポートピン自動配置 ※	7	サポートピン	13	SPI フィードバック機能
2	クリームはんだ自動供給 ※	8	基板吸着ユニット	14	クリームはんだ高さ検出機能 ※
3	THスキージ	9	基板吸着ピン	15	温度調整器
4	メタルスキージ	10	マスク吸着	16	FAパソコン対応 ※
5	ウレタンスキージ	11	基板押え機能	17	L/Rコンペア(サイドコンペア) ※
6	サポートピンプレート	12	マスクアタッチメント	18	ジョグペンダント

※工場オプション：本体ご注文時に選択いただくオプションになります

## オプションイメージ図



天竜精機株式会社  
TENRYUSEIKI CO.,LTD.

お問い合わせ窓口